

Funktionen

Wärmeleitung, -verteilung
Stromleitung
Gravurschicht

Löt- und Bondschicht
Rekonturierung

Anwendungen

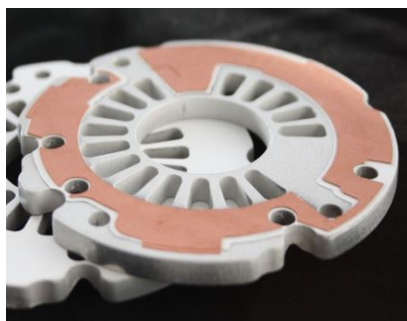
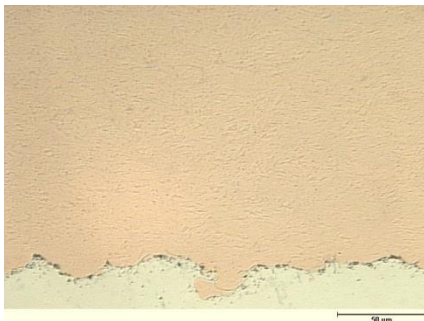
Leistungselektronik-Kühlkörper
Stromschienen
Leiterbahnen
Kokillen

Schaltungsträger
Stromkontaktierungen
Gravurwalzen

Eigenschaften (Richtw.)

Schichtdicke:	D =	0,05... > 5 mm
Porosität:	Φ <	0,5 %
Oxidgehalt:	<	0,1 %
Rauheit gespritzt:	$R_z \approx$	30 μ m
Rauheit poliert:	R_a <	0,1 μ m

Sehr hohe Konturschärfe lokaler Beschichtungen
Beste Leitfähigkeiten aller thermisch gespritzten Schichten
Geringe thermische Beeinflussung des Substratmaterials beim Beschichten



Chemische Spezifikation

Cu

Physikalische Spezifikation

Härte: ca. 180 HV_{0,3}

Dichte: 8,9 g/cm³

Haftzugfestigkeit
(EN582): > 40 N/mm²

Elektrische Leitfähigkeit
(Vergleich E-Kupfer): 45...95 %

Wärmeleitfähigkeit:

Spritzverfahren

CGS: Kaltgasspritzen